

3月市场洞察报告

半导体市场分析与趋势展望

“DISTINCTIVE
INSIGHTS,
INFORMED
DECISION-MAKING”

洞察行情 精准决策

序言

本报告由安芯易电子商务（深圳）有限公司推出，旨在为客户、供应商及合作伙伴提供半导体行业资讯及市场趋势预测，报告涵盖宏观动态、半导体产业动态、终端市场动态、重点产品行情等模块，助力行情洞察、精准决策。

本报告每月更新，可关注安芯易电子微信公众号，及时获取报告发布等信息。您也可以通过联系安芯易客户经理获取完整版报告。

目录

摘要 4

一、宏观动态 6

 (一) 行业政策 6

 (二) 经济指数 7

二、半导体产业动态 12

 厂商动态深度解读 13

三、终端市场动态 19

 (一) 人工智能 20

 (二) 汽车 21

 (三) 医疗 22

 (四) 工业 22

 (五) 机器人 23

四、重点产品行情 25

 (一) 存储芯片 25

 (二) 存储设备 26

 (三) MCU 27

信息来源 29

免责声明 36

摘要

2026 年 3 月重点行情趋势	
宏观动态	● 中东：霍尔木兹海峡封锁引发半导体供应链系统性风险 ● 美国：酝酿 AI 芯片出口新规，强化“技术换投资”与全球算力主导权 ● 欧盟：外资审查框架全面升级，FDI 新规与《工业加速器法案》并行推进 ● 日本：推进“AI·半导体·机器人”三位一体战略，锚定 2040 年 40 万亿日元销售目标 ● 中国：“十五五”规划确立半导体支柱地位，大基金三期进入密集投资期
产业动态	● 德州仪器：自 4 月 1 日起启动第二次全面涨价，涨幅 15%-85%，工业/汽车类现货价涨 30%-60% ● 亚德诺：全系产品自 4 月 1 日起涨价 5%-10%，PMIC 产品线涨幅居前 ● 英飞凌：自 4 月 1 日起全面上调功率 IC 价格，车规 IGBT/SiC 涨幅 10%-20%，交期最长 30 周 ● 恩智浦：4 月 1 日起调价，车规 MCU 及 CAN 收发器交期 40 周以上 ● 意法半导体：4 月 26 日起上调 MCU 及核心产品价格，涨幅 3%-15%，功率器件交期 10-26 周 ● 安森美：3 月 16 日发布涨价函，自 4 月 1 日起对部分产品调价，AI 服务器相关 MOSFET 涨幅最大 ● 微芯科技：汽车级 MCU 及 32 位 MCU 需求显著增加，热门型号 PIC18F 系列交期超 30 周 ● 瑞萨电子：AI 需求拉动服务器/数据中心电源 IC 需求强劲，CPU 多相控制器及 SPS 交期 24-38 周 ● 三星电子：Q1 DRAM 合约价翻倍上涨，Q2 统一上调 40%；2nm 良率提升至 60%以上 ● SK 海力士：2026 年 HBM 产能提前售罄、DDR4 减产，会长称晶圆短缺或持续至 2030 年 ● 美光：完成 18 亿美元收购力积电铜锣 P5 厂区，预计 2027 年下半年贡献超 10%全球产能 ● 铠侠：宣布停产 TSOP 封装 MLC NAND，利基型存储产品加速退场 ● 博通：Q1 AI 收入同比增 106%，预计 2027 年 AI 芯片收入超千亿美元；高端互连器件缺货成常态 ● 赛灵思：AI 算力需求驱动 FPGA 全系列提价 10%-20%，部分型号涨幅达 60%，XC7 交期延至 23 周 ● 村田制作所：针对 AI 服务器和高端车规 MLCC 涨价 15%-35%，4 月 1 日生效，银价暴涨为主因 ● 国巨、厚声、华新科：调涨电阻产品价格 15%-20%，被动元件涨价潮蔓延 ● 矽创/奕力/联咏/天钰/瑞鼎/敦泰：六大台系 IC 设计厂商集体涨价，4 月 1 日起执行，驱动 IC 涨幅最高 20%

终端市场	人工智能 ● 微软：资本支出激增与专用推理转型 ● 亚马逊云服务（AWS）与谷歌：部署 100 万+ GPU 支持智能体 AI ● 英伟达：从芯片供应商转型为平台提供商 ● 国内 AI：寒武纪产能三倍增长 汽车 ● 特斯拉与比亚迪：市场复苏与价格战格局 ● 丰田：混动扩张与氢能战略转向 ● 名爵（MG）：半固态电池商业化 ● 全球供应链风险：AI 产能竞争对汽车生产的影响 医疗 ● 通用医疗（GE HealthCare）：AI 驱动的精准诊断 ● 西门子医疗与飞利浦：无氦 MRI 的结构性转型 ● 美敦力与史赛克：手术机器人需求激增 工业 ● 西门子：以质量标准抵御 AI 冲击 ● 富士康：加速越南 AI 服务器与芯片产能布局 ● 华为：全球发布 Wi-Fi 7 推动“工业无线化” 机器人 ● 优必选与西门子：1 万台工业人形机器人部署协议 ● Agibot:人形机器人产量突破 1 万台并实现工业化落地 ● 奥比中光与 LionsBot：自主清洁机器人战略合作 ● Corvus Robotic：无人机库存系统大规模部署
产品行情	● 存储芯片供需失衡至 2028，存储价格全面上涨 ● 存储设备供应持续紧张，产能缩减催生长期绑定 ● MCU 价格全面上涨，车规供应紧张交期拉长

一、宏观动态

（一）行业政策

● 中东：霍尔木兹海峡封锁引发半导体供应链系统性风险

2月28日，美以对伊朗发动军事打击后，伊朗宣布全面封锁霍尔木兹海峡，并于3月底通过立法强化管控。作为全球约20%石油与30%氮气的运输要道，海峡受阻对半导体产业链形成多重冲击。卡塔尔氮气工厂遭袭停产（占全球供应约1/3），氮气现货价格飙升超50%，韩国64.7%的氮气进口依赖卡塔尔，三星电子、SK海力士已紧急启动库存管理。石化副产品工程塑料价格上涨5%-20%，直接影响半导体设备成本（塑料占生产成本10%-20%）。日本掌控全球90%以上高端光刻胶市场，其原料高度依赖中东石油，若封锁持续，原料库存仅剩3-6个月，ArF/EUV光刻胶断供风险显著上升。亚马逊AWS位于阿联酋和巴林的3座数据中心遭袭，英伟达关闭迪拜办公室。布伦特原油突破120美元/桶，航运绕行使运输周期延长20-30天，战争保险费率暴涨逾10倍。即便冲突缓和，拉斯拉凡工业城重建或需数年，氮气及光刻胶原料短缺将成为中长期风险，推动全球供应链向区域化、多元化及自主可控方向重构。

● 美国：酝酿AI芯片出口新规，强化“技术换投资”与全球算力主导权

2026年3月，美国在AI芯片出口管制领域呈现系统性政策调整趋势。根据3月5日相关消息，美国商务部正酝酿新一轮出口监管框架，拟以算力规模为核心划分标准，对高端AI芯片出口实施分级管控：小规模部署亦可能纳入许可范围，中等规模需提供政府间安全承诺，而大规模（如10万至20万颗以上）采购则需附加对美投资或安全条件，包括投资美国本土AI数据中心及接受监管审查，同时限制芯片集群能力以防止大规模算力系统构建。与此同时，3月中旬美国一方面撤回原有偏强监管导向的AI芯片出口规则草案，另一方面启动“美国人工智能出口计划”，推动以“全栈技术方案”形式输出算力基础设施与技术标准，标志政策从单一限制向“出口管制+技术输出+投资绑定”的组合模式转变。整体来看，美国正通过将芯片供应与资本流动、基础设施布局深度绑定，重塑全球AI算力分配与产业链主导权，短期内提高高端芯片获取门槛，中长期则加速全球半导体产业向“技术联盟化、供应链地缘化”的方向演进。

● 欧盟：外资审查框架全面升级，FDI新规与《工业加速器法案》并行推进

3月，欧盟在投资审查领域推出两项重大政策更新。其一，欧盟外商直接投资（FDI）审查法规修订文本持续推进，已于2月24日获国际贸易委员会通过，预计近期由欧洲议会正式通过。新规要求所有成员国对半导体、人工智能、量子技术、关键原材料等战略领域的外资投资实施强制性审查，并建立45天初步审查加深度评估的两阶段流程，赋予成员国最长5年的追溯审查权。其二，3月4日，欧盟委员会正式提出《工业加速器法案》（IAA）提案，针对电池技术、电动汽车、太阳能光

伏、关键原材料加工等新兴战略领域，要求外资投资额超过 1 亿欧元且取得控制权（持股 30% 以上）的须履行事前申报义务，并设置“至少满足 6 项条件中的 4 项”的严苛审批标准，包括 49% 的持股上限、本地研发与就业贡献等。上述举措显示欧盟正构建“内外双轨”的政策体系，对外收紧战略领域投资准入，对内强化本土制造能力。

● 日本：推进“AI·半导体·机器人”三位一体战略，锚定 2040 年 40 万亿日元销售目标

3 月 10 日，日本首相高市早苗主持召开“日本成长战略会议”，正式确立“AI·半导体·机器人”三位一体的产业发展战略，将其上升为国家长期竞争力工程。该战略明确：到 2040 年，日本国产半导体年销售额提升至 40 万亿日元（较 2020 年增长约 8 倍），并在全球 AI 机器人市场获得 30% 以上份额。围绕这一目标，日本推出多项配套举措：一是设立东京、北海道千岁市及九州三个半导体支援基地，分别聚焦设计研发、设备材料与化合物半导体试制，配备 EUV 光刻设备等尖端设施供初创企业及大学低成本使用；二是从 17 个战略领域选定 61 项重点产品技术实施集中扶持，涵盖 AI 半导体、量子技术、先进封装等，并强化 2nm 等先进制程量产支持；三是启动 GENIAC 计划，为企业提供 GPU 算力与数据集支持，推动生成式 AI 在制造业落地；四是推出“瓦特·比特联动”政策，统筹数据中心、电力与通信基础设施，解决 AI 算力能耗瓶颈。整体来看，日本正依托材料与精密制造优势，采取错位竞争策略，由单点技术优势向“软硬件一体化+产业生态闭环”转型，短期承接 AI 驱动的半导体需求扩张，中长期重塑全球产业链高附加值地位。

● 中国：“十五五”规划确立半导体支柱地位，大基金三期进入密集投资期

3 月，中国在顶层战略与资金支持层面同步加码半导体产业政策。战略定位方面，2026 年 3 月发布的《“十五五”规划纲要》将集成电路列为十大新产业新赛道之首，定位从“补短板”转向“全链条突破、成熟与先进并举”的进攻性战略，部署“成熟制程做精做细”与“提高先进制程制造能力”双轮驱动，聚焦高性能处理器、高密度存储器、第三代半导体及超宽禁带半导体产业化。国家发改委同期将集成电路列为六大新兴支柱产业之首。资金支持层面，国家集成电路产业投资基金三期（规模 3440 亿元）于 1 月进入密集投资阶段，明确超 70% 资金将投向半导体设备、核心材料、先进封装领域，重点补齐光刻机、刻蚀设备、光刻胶等“卡脖子”环节。工信部修订《优质中小企业梯度培育管理办法》（4 月 1 日起施行），将半导体设计、设备、材料类科技型中小企业全面纳入梯度培育体系。地方层面，深圳聚焦国产 GPU、NPU 等核心芯片应用迭代与 RISC-V 架构研发，杭州钱塘区对半导体项目给予最高 80% 房租补助及洁净室装修补贴，形成央地协同推进的政策格局。

（二）经济指数

● 2 月全球制造业 PMI 升至 51.9，创近 44 个月新高，复苏动能持续强化

2026 年 2 月，全球制造业 PMI 升至 51.9，较 1 月的 50.9 显著上行 1.0 个百分点，连续第七个月

运行于荣枯线（50）上方，创下自 2022 年 6 月以来的近 44 个月新高，显示全球制造业景气度进一步提升，复苏动能持续增强。从主要经济体来看，亚洲地区表现尤为突出：中国 PMI 升至 52.1，较 1 月大幅上升 1.8 个百分点，创逾五年新高，新出口订单显著回升成为主要驱动力；日本 PMI 升至 53.0，为近四年最高水平，产出与新订单均以强劲态势增长；印度 PMI 升至 56.9，继续保持全球主要经济体中最强劲扩张，国内需求为核心增长动力；韩国 PMI 录得 51.1，虽较 1 月微降但仍处扩张区间，半导体行业持续走强提供关键支撑。相比之下，美国 PMI 录得 51.6，虽连续第七个月处于扩张区间，但增速放缓至七个月低点，关税政策及极端天气对产出和需求形成拖累；欧元区 PMI 回升至 50.8，时隔数月重返荣枯线以上，制造业活动呈现温和修复态势。整体来看，全球制造业产出增速为 2021 年 12 月以来最快，新订单增长加速，新出口订单亦显著回升，企业信心升至近两年高位，反映国际贸易流动趋于改善，需求端逐步回暖；但区域分化依然明显，亚洲成为本轮增长主力，北美增长趋缓与欧洲修复偏弱并存。同时，地缘冲突及关税政策导致供应链压力有所上升，投入成本通胀与供应商交付周期延长问题在部分地区再度浮现。PMI 指数持续处于扩张区间并创下阶段新高，表明全球制造业复苏基础进一步巩固，有望带动电子制造、汽车及工业领域需求改善，从而对半导体及电子元器件市场形成持续支撑。

全球各地区制造业 PMI

时间	全球	中国	日本	韩国	印度	美国	欧元区
2023-11	49.30	49.40	48.30	50.00	56.00	46.70	44.20
2023-12	49.00	49.00	47.90	49.90	54.90	47.40	44.40
2024-01	50.00	49.20	48.00	51.20	56.50	49.10	46.60
2024-02	50.30	49.10	47.20	50.70	56.90	47.80	46.50
2024-03	50.60	50.80	48.20	49.80	59.10	50.30	46.10
2024-04	50.30	50.40	49.60	49.40	58.80	49.20	45.70
2024-05	50.90	49.50	50.40	51.60	57.50	48.70	47.30
2024-06	49.50	49.50	50.00	52.00	58.30	51.70	45.60
2024-07	49.80	49.40	49.10	51.40	58.10	46.80	45.80
2024-08	48.90	49.10	49.80	51.90	57.50	47.20	45.60
2024-09	48.80	49.80	49.70	48.30	56.50	47.20	45.00
2024-10	48.80	50.10	49.80	48.30	57.50	46.50	46.00
2024-11	50.00	50.30	49.00	50.60	56.50	48.40	45.20
2024-12	49.60	50.10	49.60	49.00	56.40	49.20	45.10
2025-1	50.10	49.10	48.70	50.30	57.70	50.90	46.60
2025-2	50.60	50.20	49.00	49.90	56.30	50.30	47.60
2025-3	50.30	50.50	48.40	49.10	58.10	49.00	48.60
2025-4	49.80	49.00	48.70	47.50	58.20	48.70	49.00
2025-5	49.60	49.50	49.40	47.70	57.60	48.50	49.50
2025-6	50.30	49.70	50.10	48.70	58.40	49.00	50.50
2025-7	49.70	49.30	49.90	48.00	59.20	48.00	49.80
2025-8	50.90	50.50	52.00	48.30	59.30	53.00	50.70
2025-9	50.70	51.20	48.50	50.70	57.70	52.00	49.80

2025-10	50.90	50.60	48.20	49.40	59.20	52.50	50.00
2025-11	50.50	49.90	48.70	49.40	56.60	52.20	49.60
2025-12	50.40	50.10	50.00	50.10	55.00	51.80	48.80
2026-01	50.90	50.30	51.50	51.20	55.40	52.40	49.50
2026-02	51.90	52.10	53.00	51.10	56.90	51.60	50.80

数据来源：Wind

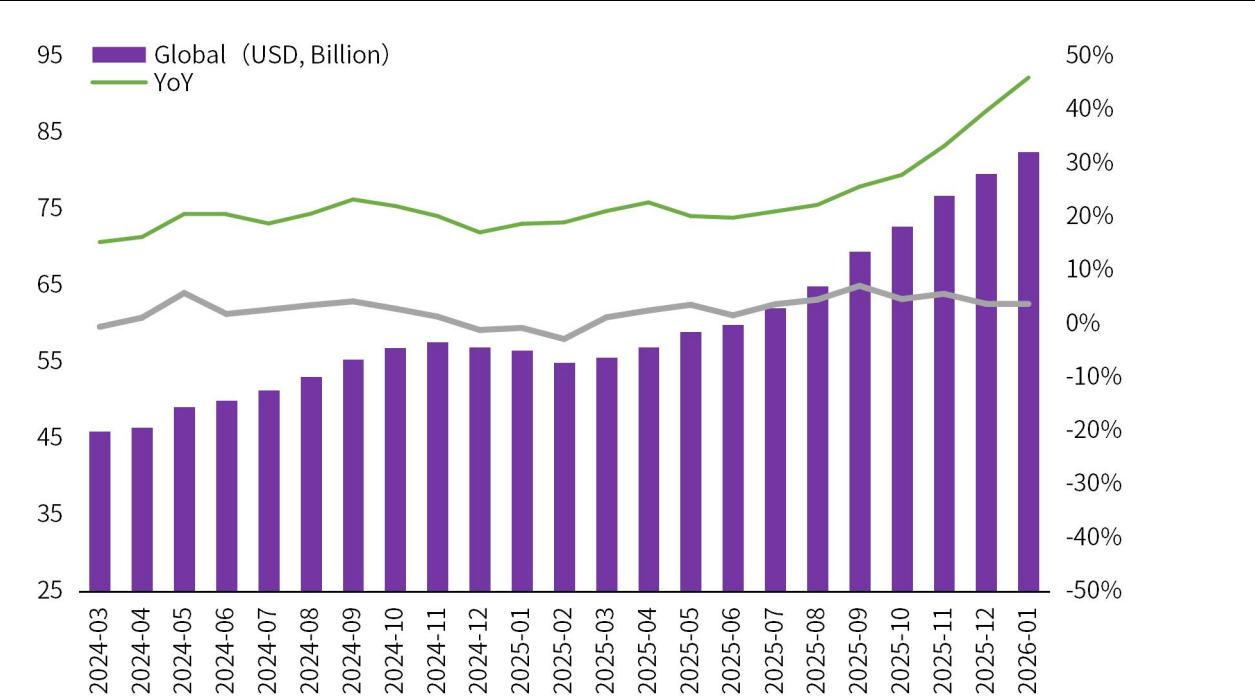
● 1 月全球半导体销售额环比增长 3.7%，亚太及中国市场贡献主要增量

2026 年 1 月，全球半导体销售额达 825 亿美元，较 2025 年 12 月的 796 亿美元环比增长 3.7%，较 2025 年 1 月的 565 亿美元同比增长 46.1%。该销售数据采用三个月移动平均统计口径，延续了 2025 年行业创纪录销售总值的增长态势，显示出全球半导体市场在年初仍保持较强增长动能。

从区域表现看，亚太及中国地区成为月度与年度增长的主要贡献方。中国销售额环比增长 5.8%、同比增长 47.0%；亚太其他地区销售额环比增长 5.0%、同比增长 82.4%；欧洲市场环比增长 5.3%、同比增长 26.1%；美洲市场环比增长 1.2%、同比增长 34.9%。日本市场则出现回调，销售额环比下降 1.7%、同比下降 6.2%，为当月唯一下滑的主要区域。区域销售结构变化显示，全球半导体需求增长主要集中在亚太及中国市场，相关地区在电子制造、数据中心及终端消费领域的重要性持续提升。

根据 SIA 引用 WSTS 数据，2026 年全球半导体销售额预计将接近 1 万亿美元，1 月开局表现为此目标的实现提供了初步支撑。

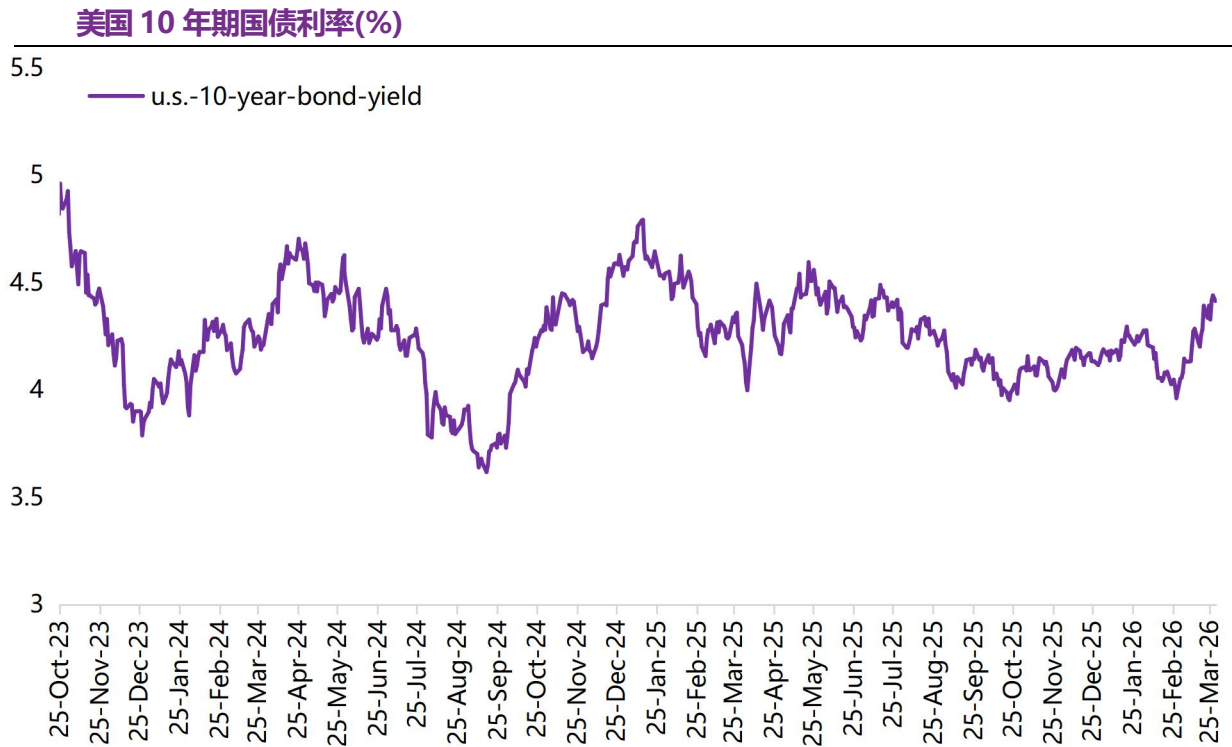
全球半导体销售额（十亿美元）



数据来源：SIA

● 3 月美国 10 年期国债收益率升至 4.44%，创近九个月新高

2026 年 3 月，美国 10 年期国债收益率快速上行至 4.44%，较 2 月末大幅走高，创下自 2025 年 7 月以来的近九个月新高。本轮收益率上行的主要驱动因素来自两方面：一是通胀数据持续高于预期，1 月核心 PCE 价格指数达 3.1%，显著高于美联储 2% 的政策目标，通胀降温进程受阻；二是中东地缘冲突升级引发能源价格飙升，布伦特原油价格一度突破 110 美元/桶，加剧市场对“二次通胀”的担忧。此外，2 月底 20 年期国债拍卖需求疲弱，反映出市场对长期限债券的风险溢价要求上升，进一步推动收益率走高。货币政策层面，美联储 3 月议息会议维持利率不变，但点阵图显示年内降息预期较年初明显收缩，市场对“higher for longer”的利率环境形成共识。作为全球资产定价的“锚”，10 年期国债收益率维持高位意味着金融条件趋紧，对半导体等高成长性科技板块的估值形成压力，后续需持续关注通胀走势及美联储政策信号对收益率曲线的传导效应。



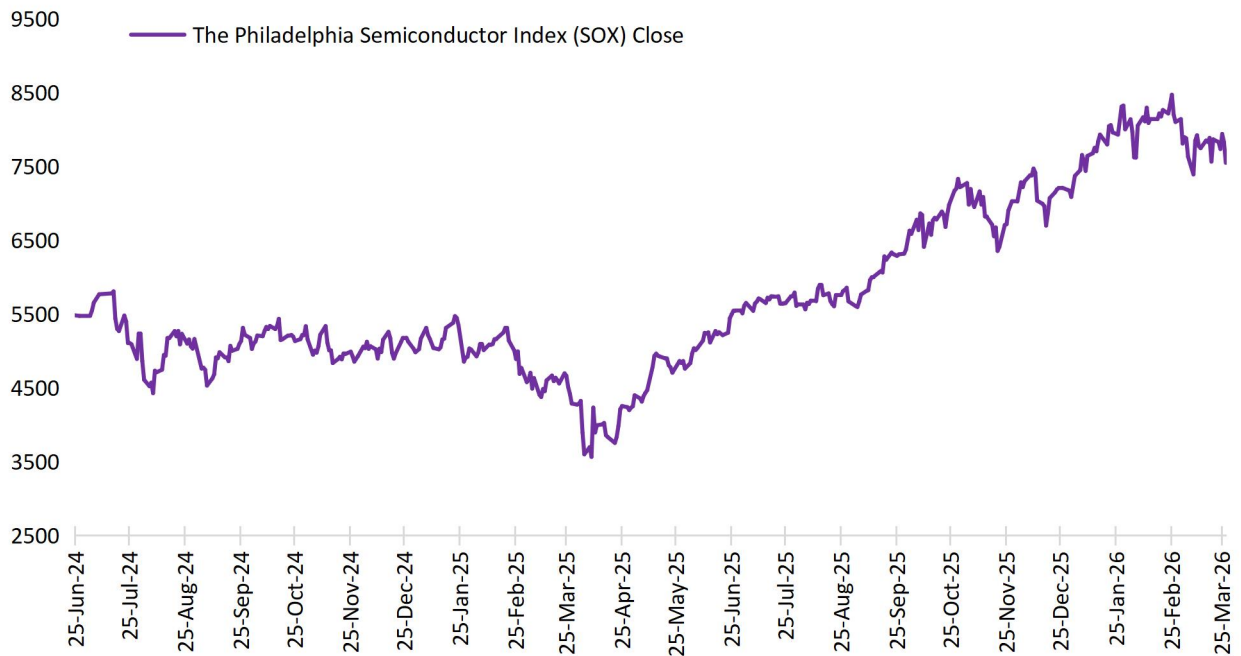
数据来源：Investing

● 费城半导体指数 (SOX) 走势分析：3 月高位回调至 7500 点区间，震荡整理特征显现

2026 年 3 月，费城半导体指数 (SOX) 在 2 月创下约 8467 点阶段高位后，整体进入“高位回调—震荡整理”的运行阶段。从具体走势看，月初指数仍处于高位，3 月 2 日收于 8137.36 点，随后快速回落，3 月 9 日下探至月内低点 7388.33 点，较月初高点累计下跌约 9.2%，反映出前期涨幅较大背景下，市场出现集中获利了结与风险偏好收缩。进入 3 月中旬，指数逐步企稳并展开技术性

修复，3月11日回升至7918.28点，随后整体在7700–7900点区间震荡运行，3月20日及3月25日分别反弹至7862.66点和7935.73点，但均未有效突破8000点关口，显示上方存在较强压力。全月来看，SOX指数波动区间为7388–8137点，振幅约9.2%，月末（3月27日）收于7545.42点，较月初水平明显下移，震荡中枢由前期8000点上方下移至7500–7800点区间。本轮调整主要源于前期AI驱动行情累积较大涨幅带来的获利了结压力、市场对AI投资回报周期的短期不确定性升温，以及美债收益率上行对高估值科技板块的宏观压制。尽管短期波动加剧，但指数月末仍收于7500点上方，运行于中长期上升通道之中，在AI算力需求持续释放、先进制程投资推进以及存储周期修复的支撑下，半导体行业基本面依然稳固，中长期仍具备重回上行趋势的基础。

费城半导体指数(SOX)



数据来源：MacroMicro

二、半导体产业动态

半导体产业动态概览		
厂商	经营动态	解读
德州仪器 TI	自 4 月 1 日起第二次全面涨价，涨幅 15%-85%	覆盖数字隔离器、栅极驱动器、PMIC 等工控/车规芯片；工业/汽车类现货价涨 30%-60%，交期 16-26 周；DSP 如 TMS320C6678x 等交期 18 周左右。
亚德诺 ADI	全系产品自 4 月 1 日起涨价 5%-10%，PMIC 产品线涨幅居前	接口隔离 IC、开关/多路复用器交期 19-22 周；线性产品 24-40 周；Maxim 产品 19-40 周；受 AI 产能占用，期货周期延至 39 周。
英飞凌 INFINEON	自 4 月 1 日起全面上调功率 IC 价格，车规 IGBT/SiC 涨幅 10%-20%	功率开关/IC/PMIC 涨幅 5%-15%；车规 IGBT/SiC 模块交期 16-30 周，部分紧缺型号停止接单；AI 服务器功率器件 20-50 周。
恩智浦 NXP	4 月 1 日起调价，车规 MCU 及 CAN 收发器交期 40 周以上	S32K、MPC57 系列 MCU 及 TJA1042 CAN 收发器交期 40-50 周；中高端嵌入式处理器及车规 MCU 涨幅最高 20%（涉及 9000 多个型号）。
意法半导体 STMicroelectronics	4 月 26 日起上调 MCU 及核心产品价格，涨幅 3%-15%	低压/高压 MOSFET、IGBT、ESD 交期 10-26 周；32 位 MCU 交期 15-28 周；车规级 MCU 交期 36-40 周；通用 STM32F/L 系列缩短至 12-18 周。
安森美 Onsemi	3 月 16 日发涨价函，4 月 1 日起部分产品调价	MOSFET、晶体管、部分 PMIC 价格上涨；交期平均 18-40 周，部分达 46 周以上；AI 服务器相关涨幅最大。
微芯科技 Microchip	汽车级 MCU 及 32 位 MCU 需求大增，热门型号交期超 30 周	PIC18F26K83/46K83 交期超 30 周；ATMEGA328P 等 12-20 周；8/16 位 MCU 交期延长至 16-24 周，车规级 PICx 达 48 周。
瑞萨电子 Renesas	AI 服务器电源 IC 需求强劲，交期 24-38 周，现货涨价	CPU 多相控制器及 SPS（ISL9931、RAA270、ISL95869 等）需求爆发；交期 24-38 周，供应紧张未缓解。
三星电子 Samsung	Q1 DRAM 合约价翻倍，Q2 统一上调 40%；2nm 良率提升至 60%+	LPDDR5X（供苹果）涨价 100%已获客户接受；消费级 DRAM 库存降至 4 周；2nm 良率 60%+，已为客户提供 2nm 制造服务。
SK 海力士 SK Hynix	2026 年 HBM 产能提前售罄、DDR4 减产；会长称短缺或持续至 2030 年	HBM 及 DDR5 营收占比超 40%；Q1 服务器 DDR5 环比+150%，NAND+130%-150%；供应缺口或超 20%。

美光 Micron	完成 18 亿美元收购力积电铜锣 P5 厂区，扩充 HBM 产能	铜锣厂将扩充先进 DRAM 及 HBM 产能，预计 2027 年下半年贡献相当于美光 Q4 全球产能 10%以上。
铠侠 Kioxia	宣布停产 TSOP 封装 MLC NAND，2027 年 3 月最后出货	8Gb-64Gb MLC NAND 停产；市场向 TLC/QLC 迁移，利基型 SLC/MLC 产品加速整合。
博通 Broadcom	Q1 AI 收入同比增 106%；PCIe 及 SX 系列缺货严重，价格暴涨	PCIe 系列（SS24/SS26）价格剧烈波动；SX 系列拓展卡长期缺货，部分型号较 2025 年初涨幅超 10 倍；高端交换芯片交期极度紧张。
赛灵思 Xilinx	3 月起全系列 FPGA 提价 10%-20%，部分型号涨幅达 60%	16nm/20nm FPGA 交期 40-52 周；28nm 7 系列 24-52 周；XC7 系列延至 23 周；AI 服务器需求突破 350 万片。
村田制作所 Murata	针对 AI 服务器和高端车规 MLCC 涨价 15%-35%，4 月 1 日生效	多层铁氧体电感、共模扼流圈等涨价；银价暴涨及 AI 需求驱动；车规级、AI 服务器专用 MLCC 价格涨 10%-20%。
国巨/厚声/华新科 Yageo/UNI-ROYAL/Walsin Technology	调涨电阻产品价格 15%-20%	国巨涨 15%-20%，厚声、华新科跟涨；KEMET 钽电容三次涨价累计 40%-50%；白银涨价及 AI 需求驱动。
矽创/奕力/联咏/天钰/瑞鼎/敦泰 Sitronix/ILITEK/Novatek/Fitipower/Raydium/FocalTech	4 月 1 日起集体涨价，驱动 IC 涨幅最高 20%	矽创、奕力驱动 IC 调涨 15%-20%；联咏时序控制 IC 涨价；晶圆代工与封测成本攀升，驱动 IC 产能收紧。

厂商动态深度解读

- **德州仪器：自 4 月 1 日起启动第二次全面涨价，涨幅 15%-85%，工业/汽车类现货价涨 30%-60%**

德州仪器自 2026 年 4 月 1 日起执行新一轮涨价，涨幅 15%-85%，覆盖数字隔离器、栅极驱动器、电源管理 IC 等工控与车规核心芯片。工业与汽车类核心产品现货报价较上月上涨 30%-60%，交期延长至 16-26 周。DSP 产品如 TMS320C6678x/6674x/6416x/6455x 平均交期 18 周左右，未来存在涨价压力。通用物料如 CCx 无线连接芯片、SNx 逻辑芯片、TPSx、TLVx 等现货市场异常活跃，部分供应商报价有效期仅一小时。目前代理渠道 PPV 报价难获取，部分年前订货型号已延期。

● **亚德诺半导体：全系产品自 4 月 1 日起涨价 5%-10%，PMIC 产品线涨幅居前**

亚德诺半导体于 2026 年 3 月 10 日发布调价通知，因封装基板及贵金属成本上涨，全系产品自 4 月 1 日起上调 5%-10%，其中 Maxim 整合后的 PMIC 产品线涨幅居前。具体交期方面：接口隔离 IC、开关与多路复用器 IC 货期 19-22 周；线性产品 24-40 周；MAXIM 产品 19-40 周。受 AI 产能占用，下半年晶圆供应较为紧张，ADI 期货周期已由 20 周以内延长至 39 周水平。2026 财年第一季度，通信业务同比增长 63%，工业业务增长 38%。

● **英飞凌：自 4 月 1 日起全面上调功率 IC 价格，车规 IGBT/SiC 涨幅 10%-20%，交期最长 30 周**

英飞凌于 2026 年 2 月 5 日发布调价函，新价格自 4 月 1 日起全面生效，功率开关、功率 IC 及 PMIC 主流产品涨幅 5%-15%，车规级 IGBT、SiC 模块及高端 MOSFET 涨幅达 10%-20%。交期方面：车规 IGBT/SiC 模块常规型号 16-20 周，高端型号 24-30 周，部分紧缺型号已停止接单；AI 服务器功率器件交期 20-50 周，高密度电源管理 IC 超 52 周；工业及通用器件交期 12-18 周，但供给持续收紧。受 Nexperia 部分车规级 MOS 和晶体管缺货影响，英飞凌替代品功率 MOSFET（IPW/IPB/IKW 系列）也开始涨价。

● **恩智浦：4 月 1 日起调价，车规 MCU 及 CAN 收发器交期 40 周以上**

恩智浦半导体自 2026 年 4 月 1 日起对部分产品线调价，涉及 9000 多个型号，中高端嵌入式处理器及车规级 MCU 涨幅最高达 20%。汽车微控制器（S32K、MPC57 系列）及 CAN 收发器（TJA1042）供应持续紧张，交货周期普遍维持在 40 周以上，部分达 40-50 周。传统 16/32 位 MCU、通用 MCU、汽车 MCU 货期 14-54 周，价格全部上涨。汽车行业需求强劲是主因。

● **意法半导体：4 月 26 日起上调 MCU 及核心产品价格，涨幅 3%-15%，功率器件交期 10-26 周**

意法半导体于 2026 年 3 月 24 日发布涨价函，自 4 月 26 日起对功率转换、MEMS 传感器、STM32 主流系列等核心产品线提价，市场预期涨幅 3%-15%。本月车规物料和分立器件短缺需求明显增加：低压/高压 MOSFET、IGBT、ESD 器件交期 10-26 周；二三极管与晶体管 14-20 周；模拟器件中驱动器交期 18-30 周；32 位 MCU 交期上升至 15-28 周。通用 STM32F/L 系列交货周期已缩短至 12-18 周，市场竞争加剧；但车规级产品依旧紧张，交货周期仍长达 36-40 周。电源管理 IC 和 EEPROM 也出现阶段性缺料。

- **安森美：3月16日发布涨价函，自4月1日起对部分产品调价，AI服务器相关MOSFET涨幅最大**

安森美于2026年3月16日通知客户，自4月1日起对部分产品调价。通知指出，支持功率、工业及数据中心（尤其是AI服务器）的市场需求显著增长，叠加原材料、制造及能源成本持续上涨。据渠道消息，MOSFET产品将全面受涨价影响，AI服务器相关涨幅最大。目前交期平均在18-40周，部分已达46周以上或更长。新价格适用于4月1日及之后的新订单及未交付订单。

- **微芯科技：汽车级MCU及32位MCU需求显著增加，热门型号PIC18F系列交期超30周**

2026年3月，Microchip汽车电子需求显著回升，车规级MCU开始供不应求。热门型号PIC18F26K83和PIC18F46K83交货周期已超过30周。尽管许多AVR器件仍有库存，但经典型号如ATMEGA328P、ATMEGA32U4需求稳定，交期约12-20周。32位MCU需求明显增加，许多新设计正从8位和16位MCU转向32位MCU。8/16位MCU交期延长至16-24周左右，个别车规级器件PICx交期拉长到48周。本月存储EEPROM（开头24/25/AT2）现货报价涨幅在10%-30%，部分翻倍。

- **瑞萨电子：AI需求拉动服务器/数据中心电源IC需求强劲，CPU多相控制器及SPS交期24-38周**

受AI需求拉动，瑞萨电子在服务器/数据中心的电源IC，特别是CPU多相控制器及SPS智能功率级出现强劲需求，代表系列包括ISL9931、RAA270、ISL95869等。整体交期预计24-38周，供应紧张态势尚未出现明显缓解迹象。现货市场开始涨价，反映AI基础设施投资对电源管理芯片的拉动效应持续扩大。

- **三星电子：Q1 DRAM合约价翻倍上涨，Q2统一上调40%；2nm良率提升至60%以上**

三星电子于2026年3月完成第一季度DRAM合约价格谈判，PC及移动端通用DRAM价格环比上涨100%，LPDDR5X（供苹果）涨价100%已获客户接受；海外客户开始预付货款锁定产能；合同周期从年度缩短至季度或月度。公司面临潜在罢工风险。随着三星及SK海力士将大量标准DRAM产能转向HBM生产，消费级DRAM出现结构性缺口，全球DRAM库存降至4周历史低位。此外，三星2nm制程良率已提升至60%以上（2025年下半年仅约20%），正逐步缩小与台积电的差距，已为部分客户提供2nm制造服务。DDR5价格本月首现回落，存储市场进入分化调整期。

- **SK 海力士：2026 年 HBM 产能提前售罄、DDR4 减产，会长称晶圆短缺或持续至 2030 年**

SK 海力士于 2026 年 3 月披露，2026 年 HBM 产能已提前售罄，同时宣布对 DDR4 旧料号实施减产。HBM 及 DDR5 产品占营收比重突破 40%，产能向高附加值产品倾斜。据 Counterpoint Research 数据，2026 年第一季度存储芯片价格飙升：服务器用 64GB DDR5 RDIMM 价格环比上涨 150%，移动端 12GB LPDDR5X 上涨 130%，前代产品 8GB DDR4 SO-DIMM 暴涨 180%，NAND 闪存整体涨幅约 130%-150%。SK 集团会长崔泰源表示，AI 驱动的需求持续超过供应，芯片生产存在系统性瓶颈，全球存储芯片短缺可能持续到 2030 年，增加产能至少需要四到五年，供应缺口可能超过 20%。

- **美光：完成 18 亿美元收购力积电铜锣 P5 厂区，预计 2027 年下半年贡献超 10% 全球产能**

2026 年 3 月 16 日，美光科技宣布完成对力积电位于中国台湾苗栗县铜锣 P5 厂区的收购，交易金额 18 亿美元。该厂区拥有约 30 万平方英尺的 300mm 独立无尘室空间，将支持美光补充先进 DRAM 产品（包括 HBM）的供应能力。铜锣厂将与台中大型厂区垂直整合，预计自 2028 财年起规模化出货。据 TrendForce 分析，铜锣一期预计于 2027 年下半年贡献产能，相当于美光 2026 年第四季全球产能的 10% 以上。

- **铠侠：宣布停产 TSOP 封装 MLC NAND，利基型存储产品加速退场**

据 TrendForce 及 Bitget 报道，铠侠宣布停产 TSOP 封装的 MLC NAND 产品，最终出货日期为 2027 年 3 月 15 日。最终预测订单截止日期为 2026 年 5 月 30 日，最后客户订单截止日期为 2026 年 9 月 15 日。受影响产品涵盖 8Gb 至 64Gb MLC NAND。随着存储市场向高密度 TLC 及 QLC NAND 迁移，MLC 产品的经济性持续下降，相关应用需提前规划替代方案。同时，NOR Flash 受 AI 服务器架构升级需求驱动，预计 Q2 合约价格再涨 40%-50%。

- **博通：Q1 AI 收入同比增 106%，预计 2027 年 AI 芯片收入超千亿美元；高端互连器件缺货成常态**

2026 年 3 月 4 日，博通公布 2026 财年第一季度财报，AI 相关半导体收入 84 亿美元，同比增长 106%，占半导体业务收入的 67%。公司给出第二季度指引，预计 AI 半导体收入攀升至 107 亿美元。陈福阳预测，到 2027 年仅 AI 芯片业务即可实现超 1000 亿美元年收入。据市场渠道反馈，博通 PCIe 系列（如 SS24、SS26）价格波动剧烈，SX 系列拓展卡长期缺货，部分型号较 2025 年初涨幅超过 10 倍；高端交换芯片交期极度

紧张，大厂普遍排队分货。AI 基础设施建设周期内，博通相关产品缺货将成为常态。

- **赛灵思：AI 算力需求驱动 FPGA 全系列提价 10%-20%，部分型号涨幅达 60%，XC7 交期延至 23 周**

AI 算力需求成为 Xilinx FPGA 增长的核心驱动力，高端智算服务器单台 FPGA 用量达 8-12 颗，是传统服务器的 3-5 倍，预计 2026 年全球 AI 服务器 FPGA 需求量将突破 350 万片。供应端持续收紧：16nm、20nm FPGA 交期 40-52 周；28nm 7 系列 FPGA、SoC 交期 24-52 周；XC7 系列交期已从 14 周延至 23 周。台积电等代工厂将产能优先分配给 AI 相关先进制程，挤压成熟制程产能。Xilinx 已于 2026 年 3 月起全系列主力产品提价 10%-20%，其中经典系列涨幅达 20%，部分含封装存储的 FPGA 型号涨幅高达 60%。

- **村田制作所：针对 AI 服务器和高端车规 MLCC 涨价 15%-35%，4 月 1 日生效，银价暴涨为主因**

2026 年 3 月中旬，村田制作所发布涨价函，针对 AI 服务器和高端车规级 MLCC 产品全面涨价，涨幅 15%-35%，4 月 1 日生效。涨价产品包括多层型芯片铁氧体珠、多层铁氧体功率电感器、多层型射频电感器、多层型共模扼流圈等。村田制作所表示，上述产品使用银为原材料，银价快速上涨导致成本上升超出降本承受范围。车规级、AI 服务器专用的高端 MLCC 价格涨幅 10%-20%。AI 投资将在未来 3-5 年保持强劲增长，下一代 AI 芯片所需高端 MLCC 数量增长数十倍。

- **国巨、厚声、华新科：调涨电阻产品价格 15%-20%，被动元件涨价潮蔓延**

2026 年 3 月，被动元件厂商陆续发布涨价函。国巨调涨幅度约 15%-20%，厚声调涨 0402-1206 电阻产品，华新科调涨 0201-1206 电阻产品。此前 KEMET 钽电容已于 2025 年 10 月、2026 年 3 月三次涨价（累计涨幅 40%-50%）：2025 年 6 月首次对聚合物钽电容部分规格涨价 20% 以上；2025 年 11 月调涨 T520、T521、T530 系列 20%-30%；2026 年 3 月调整 T523 系列，涨幅至少 20% 以上。WALSIN、YAGEO 等亦于 1-2 月调涨。本轮涨价原因：一是原材料白银价格暴涨；二是 AI 为首的高端需求快速增长。钽电容货期方面，AVX 20-28 周，Kemet/Yageo 28-47 周。

- **矽创/奕力/联咏/天钰/瑞鼎/敦泰：六大台系 IC 设计厂商集体涨价，4 月 1 日起执行，驱动 IC 涨幅最高 20%**

据台媒报道，矽创 (Sitronix)、奕力 (ILITEK)、联咏 (Novatek)、天钰 (Fitipower)、

瑞鼎 (Raydium)、敦泰 (FocalTech) 等六大台系芯片设计厂商已陆续启动涨价, 部分产品涨幅最高达 20%, 多家厂商自 4 月 1 日起执行。矽创与奕力的驱动 IC 调涨 15%-20%, 联咏的时序控制 IC 涨价, 天钰与瑞鼎跟进, 敦泰的触控与驱动整合 IC 酝酿调升。前段晶圆制造与后段封测成本持续上升, 晶圆厂对驱动 IC 供应产能持续收紧并上调代工价格, 封测成本受贵金属、封装材料及人力成本上升影响, 整体供应链成本增幅已超过 IC 设计厂商自身消化范围。

三、终端市场动态

终端市场动态概览		
类别	厂商	3 月市场动态
人工智能	Microsoft (微软)	微软 2026 财年资本支出增至 1460 亿美元，战略重心转向推理集群。
	AWS / Google (亚马逊云服务 / 谷歌)	亚马逊云服务部署 100 万个以上英伟达 GPU，以支持自主智能体 AI 系统。
	NVIDIA (英伟达)	英伟达正式从硬件销售模式转型为 AI 平台软件订阅模式。
	Cambricon (寒武纪)	寒武纪 2026 年产能提升 3 倍，以填补英伟达禁运导致的供应缺口。
汽车	Tesla/ BYD (特斯拉 / 比亚迪)	特斯拉结束下滑，比亚迪凭借供应链整合优势迫使行业调整 MCU 降本要求。
	Toyota (丰田)	丰田增资 10 亿美元扩建美国混动工厂，并将氢能研发重心转向商用领域。
	MG (名爵)	名爵在欧洲推出半固态电池 MG4，重点通过规模化生产降低高新技术成本。
	Global OEMs 全球 OEM 厂商	AI 数据中心占用 70% 存储产能，恐导致 2026 年全球汽车减产 60 万辆。
医疗	GE HealthCare	GE 医疗拥有 115 项 FDA AI 认证位居行业首位，研发重心转向 AI 引导的 MRI 与心脏超声。
	Siemens, Philips (西门子、飞利浦)	飞利浦凭借 31.9% 市场份额优势加速无氦 MRI 转型，研发重心转向高效散热芯片以应对氦气风险。
	Medtronic, Stryker (美敦力、史赛克)	手术机器人市场规模达 300 亿美元，推动 Medtronic 与 Stryker 对高精度运动控制 MCU 的采购需求。
工业	Siemens (西门子)	西门子凭借高精度行业标准抵御 AI 冲击，研发重心转向工业 AI、数字孪生及芯片设计。
	Foxconn (富士康)	越南总投资超 40 亿美元，富联与讯芯加速布局 AI 服务器及芯片封装产能。

	Huawei (华为)	华为 Wi-Fi 7 出货量超 200 万台位居全球第一，实现机器人微秒级同步。
机器人	UBTech (优必选)	优必选与西门子目标 2026 年交付 1 万台人形机器人，标志着工业终端迈入万台级规模化阶段。
	智元机器人 (Agibot)	智元第 10000 台人形机器人在上海下线，三个月内产能翻倍，迈入大规模工业部署阶段。
	LionsBot 新加坡机器人制造公司	新加坡 LionsBot 与奥比中光深化合作，为其全球 5000 多台机器人车队集成 3D 与激光雷达视觉。
	Corvus Robotics	Corvus Robotics 通过与 Dermalogica 和 Southern Glazer's 的合作，扩大无人机库存盘点系统在物流领域的应用。

(一) 人工智能

● 微软：资本支出激增与专用推理转型

3 月预测显示，微软 2026 财年的资本支出将达到 1460 亿美元（同比增长 66%）。在终端应用侧，微软正从通用 GPU 转向专用推理（Inference）集群。这一转变旨在应对算力成本过高以及 Copilot 用户增长不及预期的双重挑战，预示着终端市场对定制化、高效率推理芯片的需求将超过通用训练芯片。

● 亚马逊云服务（AWS）与谷歌：部署 100 万+ GPU 支持智能体 AI

AWS 宣布计划从 2026 年开始部署超过 100 万个 NVIDIA GPU（包括 Blackwell 和 Rubin 架构）。客户端的战略重心正在从单纯的“模型训练”转向**“智能体 AI 系统（Agentic AI）” **。这种自主工作流程需要持久且高密度的推理集群支持，而非短期的训练算力，这将拉动高带宽存储和高速互联组件的长期消耗。

● 英伟达：从芯片供应商转型为平台提供商

英伟达在 3 月正式完成了从“卖芯片”向“卖平台”的角色转变。企业客户不再单纯关注单一芯片参数，而是通过订阅软件平台直接获取 AI 推理能力。这一模式改变了传

统的元器件采购逻辑，分销商需关注从硬件销售向系统集成及软件生态配套的需求转型。

● 国内 AI：寒武纪产能三倍增长

为应对地缘政治导致的供应波动，国内终端算力需求方正加速转向国产方案。****寒武纪 (Cambricon) ****确认其 2026 年产能将提升 3 倍，以填补英伟达禁运后留下的高端 AI 芯片市场空白。这一动向表明，国内终端市场对国产高性能算力芯片的依赖度正进入快速上升期。

(二) 汽车

● 特斯拉与比亚迪：市场复苏与价格战格局

特斯拉在 2026 年 3 月结束了长达一年的业绩下滑，但市场竞争格局已发生改变。比亚迪凭借其更强的供应链垂直整合能力，在全球价格战中占据了战略主动权。这一局面正迫使传统车企从根本上调整采购与研发策略，特别是针对高集成度 MCU 提出了更严苛的降本要求，以维持整车的价格竞争力。

● 丰田：混动扩张与氢能战略转向

为应对超预期的混动车型 (Hybrid) 市场需求，丰田宣布增资 10 亿美元 扩建其美国工厂。此外，公司在长期能源战略上做出了重大调整：其氢能研发重心已全面转向卡车、出租车等商用领域，实际上已放弃将氢燃料电池乘用车作为研发的主攻方向。

● 名爵 (MG)：半固态电池商业化

搭载半固态电池的 MG4 在欧洲上市，标志着电动车电池研发重心的转移。目前的研发重点不再是单纯追求实验室性能指标，而是转向实现规模化生产效益。其目标是通过大规模制造降低高新技术成本，推动先进电池技术从实验室走向主流商业化应用。

● 全球供应链风险：AI 产能竞争对汽车生产的影响

由于 AI 数据中心在全球范围内占用了大量先进制程存储和逻辑产能，汽车行业正面临

严重的“产能降级风险”。根据行业预测，这种产能竞争预计将导致 2026 年全球汽车减产 60 万辆。随着供应优先级向高性能计算基础设施倾斜，车企在获取先进制程半导体节点方面正面临巨大挑战。

(三) 医疗

● 通用医疗 (GE HealthCare)：AI 驱动精准诊断

截至 2026 年 3 月，GE 医疗在 AI 授权方面持续领先（共 115 项）。其研发重心已转向用于 MRI 图像重建的深度学习（AIR Recon DL）和 AI 引导的心脏超声。这些终端升级显著拉动了医疗控制台对先进图像处理器及高速存储器的需求。

● 西门子医疗与飞利浦：无氦 MRI 的结构转型

受 3 月氦气严重短缺影响，西门子医疗与飞利浦正加速转向无氦 MRI 扫描仪。由于医疗影像占据医疗半导体市场 31.9% 的份额，这一转型正推动研发转向高效热管理芯片和专用功率半导体，以替代传统的液氦冷却系统。

● 美敦力与史赛克：手术机器人需求激增

手术机器人市场预计将达到 300 亿美元，美敦力的 Hugo RAS 和史赛克的 TMINI 在 2026 年 3 月完成了重大临床里程碑。这些机器人平台需要极高精度，随着全球医院推进数字手术室现代化，带动了高精度运动控制 MCU 和 3D 视觉 SoC 的终端订单。

(四) 工业

● 西门子：以质量标准抵御 AI 冲击

西门子强调汽车、制药等行业的“零容错”标准是其核心护城河。3 月研发重心在于将 AI 嵌入数字孪生平台，确保设计符合严苛工业认证，从而维持对高端芯片仿真软件的长期需求。

- **富士康：加速越南 AI 服务器与芯片产能布局**

富士康 3 月通过富联精密（3.81 亿美元）及讯芯（8000 万美元）加大越南投资，布局 AI 服务器及光模块芯片封测。这标志着其越南基地从简单组装转向涵盖整机与芯片封装的 HPC 基础设施中心。

- **华为：全球发布 Wi-Fi 7 推动“工业无线化”**

华为企业级 Wi-Fi 7 出货量突破 200 万套，位居全球第一。3 月研发聚焦**iCSSR（智能协同调度）**技术以实现机器人微秒级同步，推动工业终端由有线转无线，带动射频与 SoC 芯片需求。

(五) 机器人

- **优必选与西门子：1 万台工业人形机器人部署协议**

优必选与西门子正式签署战略合作协议，到 2026 年底将在全球工厂交付 1 万台工业级人形机器人。这标志着人形机器人首次在物流、分拣和装配等真实工业环境实现大规模终端部署，体现了从实验原型向可扩展商业化劳动力替代的转变。

- **Agibot：人形机器人产量突破 1 万台并实现工业化落地**

Agibot 宣布其第 1 万台人形机器人在上海下线。CTO 彭志辉确认，公司在短短三个月内将产量从 5,000 台提升至 1 万台。这些机器人正深入融入物流、零售及工业 workflow，实现从早期验证向可扩展大规模落地的转型。

- **奥比中光与 LionsBot：自主清洁机器人战略合作**

总部位于新加坡的 LionsBot 与 AI 视觉技术提供商奥比中光加强战略合作。奥比中光将成为 LionsBot R5 自主清洁机器人首选视觉技术伙伴，提供 3D 摄像头和 LiDAR 解决方案，优化高流量环境下的导航。目前 LionsBot 在 30 个国家部署了超过 5,000 台机器人。

- **Corvus Robotics: 无人机库存系统大规模部署**

Corvus Robotics 宣布其无人机自主库存管理系统大幅扩展，并与 Dermalogica 及 Southern Glazer's Wine & Spirits 达成新终端合作。自主无人机现已在多家高密度仓库中执行实时库存盘点，减少人工盘点需求，提高供应链可视化水平。

四、重点产品行情

(一) 存储芯片

2026 年 3 月存储芯片重点产品行情一览

产品	价格趋势	交期（周）	供需状态
DDR4	上涨	20-26	紧张
DDR5	上涨	18-24	紧张
HBM	上涨	24-30	紧张
NAND Flash	上涨	16-20	紧张

信息来源：CFM 闪存市场

● 存储芯片供需失衡至 2028，存储价格全面上涨

1) 产品动态

- **DDR5**：合约市场上，DDR5 一季度合约价环比涨幅超过 100%，二季度涨幅预计收敛至 30%-35%。现货市场上，DDR5 内存条价格降幅最高可达 29%。此现象或部分囤货商受 TurboQuant 影响、出于风控进行的短期抛售。
- **DRAM**：车规 DDR4 累计涨超 150%，DDR5 现货涨幅高达 300%，近三月整体涨 180%，价格已上涨 2-4 倍。 64GB DDR5 RDIMM 涨价比例达 150%，12GB LPDDR5X 涨价 130%，8GB DDR4 SODIMM 的价格涨幅更是达到了 180%。
- **NAND Flash**：TrendForce 预期季内整体 NAND 价格将按季升 85%至 90%，三星计划 Q2 将主要 NAND 产品价格再上调约 100%，上半年累计涨幅超 200%。
- **MLC NAND**：铠侠将停止生产采用薄型小尺寸封装（TSOP）的相关产品，2026 年全球 MLC 产能年减 41.7%。MLC NAND 在第 1 季合约价大幅上涨 150%，预计第 2 季 SLC/MLC NAND 报价将呈现 2 倍翻涨，部分急单也不排除可能调涨至 5 倍

2) 市场趋势

- **供需失衡持续至 2028 年：**因 AI 产能挤占，美国与韩国的存储大厂纷纷预测，这种供需紧张的局面至少会持续到 2028 年以后。
- **供应缺口加剧车企涨价：**过去 3 个月汽车领域 DRAM 涨幅达 180%，高端车规 DDR5 现货涨超 300%。单辆新能源车存储成本增加 1000—3000 元，供应满足率不足 50%，多家车企已涨价或释放信号。
- **消费级 DDR5 短期回调：**3 月下旬，主流 32GB DDR5 套装价格在一个月內下跌近三成，主因算法扰动、国产产能释放及抛售，此次降价属于技术性回调，而非行业趋势的根本反转。

(二) 存储设备

2026 年 3 月各厂商存储设备交期情况

厂商	产品	交期（周）	交期趋势
三星 (Samsung)	企业 SSD	16-24 或以上	交期延长
金士顿 Kingston	内存条	6-12	交期延长
	内存卡	6-12	交期延长
	SSD	24-26	交期延长
	eMMC	24-26	交期延长
威刚 ADATA	内存条	26-52	交期延长
	内存卡	26-52	交期延长
	SSD	26-52	交期延长
	eMMC	26-52	交期延长
戴尔 (Dell)	企业级存储系统	18-26	交期延长

信息来源：富昌电子、新浪网

- **存储设备供应持续紧张，产能缩减催生长期绑定**

1) 产品动态

- **SSD**: SDD 价格持续缓慢上行, SATA 涨幅 10%+, NVMe 稳涨。群联预计, 今年首季来自企业级 SSD 营收占比达 30%, 较去年第四季翻倍增长。
- **HDD**: 8TB 企业级 SAS 硬盘均价已经突破 2200 元, 比去年同期的 1800 元涨了将近 20%。大容量机械硬盘涨幅温和些, 18TB 的 SATA 盘目前稳定在 3100-3300 元区间。HDD 产能行业产能缩减, Q2 到货量较 Q1 减少约一半。

2) 市场趋势

- **HDD 产能缩减, 小容量价格温和上涨**: 据日经中文网报道, 1—3 月机械硬盘大宗交易价格连续 4 个季度上涨, 3.5 英寸 1TB 环比涨 1%至 53.5 美元。
- **供货条款收紧, 预付/长协模式蔓延至存储设备**: 三星正与微软、谷歌就长期供应协议展开谈判, 微软预付款超 100 亿美元, 采购量未达标则从预付款中扣除。美光已落地首份五年期战略客户协议, 2026 财年资本开支翻倍至 250 亿美元。云厂商态度从“拒绝长约”转向“主动绑定”。
- **终端售价显著上涨**: 主流消费级 SSD 价格在半年内累计上涨 50%-120%。反映到整机市场, 联想、戴尔、惠普等 PC 厂商产品涨幅普遍达 10%-30%, 部分顶配机型上涨超 5000 元; 手机厂商也因成本压力进行了近五年最大规模的集体调价。

(三) MCU

2026 年 3 月各厂商 MCU 交期情况

厂商	产品	交期 (周)	交期趋势
恩智浦 NXP	8 位 MCU	16-39	交期稳定
	32 位 MCU	16-39	交期稳定
	车规 MCU	18-52	交期稳定
瑞萨 Renesas	8 位 MCU	14-18	交期稳定
	32 位 MCU	14-18	交期稳定
	车规 MCU	24	交期稳定
意法半导体 ST	8 位 MCU	15-33	交期延长
	32 位 MCU	15-28	交期延长
	车规 MCU	40-52	交期稳定

英飞凌 Infineon	8 位 MCU	10-26	交期稳定
	32 位 MCU	10-97	交期稳定
	车规 MCU	32-45	交期稳定
微芯 Microchip	8 位 MCU	4-12	交期延长
	32 位 MCU	4-18	交期延长

数据来源：富昌电子

● **MCU 价格普遍上涨，车规供应紧张交期拉长**

1) **产品动态**

- **价格普遍上涨：**多家 MCU 厂商已实施或宣布涨价，涨幅从两位数百分比到 50% 不等。例如，部分中微半导 MCU 产品涨幅达 15%-50%；普冉股份 3 月 31 日宣布对通用 MCU 相关产品上调价格。
- **交期显著拉长：**车规级 MCU 供应尤为紧张，恩智浦 MCU 产品线也仍有 30~50 周不等交期；车规/高端 32 位 MCU 交期 16~24 周，部分型号 30 周以上；Microchip MCU 货期普遍约 20 至 40 周，但 ATMEGA AVR、PIC18F 系列交期延长至 30 周，汽车与工业领域供应持续紧张。

2) **市场趋势**

- **汽车 MCU 成为核心增长引擎：**受益于汽车智能化与电动化，车规级 MCU 需求持续强劲，恩智浦 S32 系列预计 2023-2027 年复合年增长率达 20%-30%，高于预期的未来三年汽车行业 9%-12% 的平均增长率。
- **国产化进程加速：**意法半导体与华虹半导体合作生产的国产 STM32 MCU 晶圆已实现批量交付，计划 2026 年在国内量产更多通用型 MCU 产品，有望缓解供应压力并推动本土替代。
- **价格与交期双重压力持续：**全球半导体库存去化基本完成，下游需求（尤其是汽车、工业）回暖，MCU 市场正迎来新一轮涨价与交期拉长的双重压力，将直接推高下游制造业采购成本。

信息来源

- [1] Axios. "White House Pulls Back on Sweeping AI Chip Export Controls." Axios, March 14, 2026.
- [2] ASML. "ASML Reports Full-Year 2025 Results." ASML, January 21, 2026.
- [3] Bloomberg. "Brent Crude Oil Price Surges Above \$110 on Middle East Tensions." Bloomberg, March 2026.
- [4] Bloomberg. "US Weighs New AI Chip Export Curbs Targeting Global Sales." Bloomberg, March 5, 2026.
- [5] Bloomberg. "Broadcom Forecast Signals Continued AI Chip Boom." Bloomberg, March 5, 2026.
- [6] Counterpoint Research. "DRAM and NAND Flash Price Tracker – Q1 2026." Counterpoint Research, March 2026.
- [7] Digitimes. "TSMC 2nm Capacity Fully Booked Through 2028 as AI Demand Surges." Digitimes, March 20, 2026.
- [8] European Commission. "Proposal for an Industrial Accelerator Act (IAA)." European Commission, March 4, 2026.
- [9] European Parliament. "FDI Screening Regulation Amendment Approved by International Trade Committee." European Parliament, February 24, 2026.
- [10] Federal Reserve System. "FOMC Statement and Summary of Economic Projections – March 18, 2026." Federal Reserve Board, March 18, 2026.
- [11] HSBC, S&P Global. "India Manufacturing PMI – February 2026." S&P Global, March 2026.
- [12] Investing.com. "US 10-Year Treasury Bond Yield Historical Data – March 2026." Investing.com, March 2026.
- [13] Infineon Technologies. "Infineon Announces Price Adjustment for Power IC Products." Infineon, February 5, 2026.
- [14] J.P.Morgan, S&P Global Market Intelligence. "J.P.Morgan Global Manufacturing PMI – February 2026." S&P Global, March 2026.
- [15] MarketWatch. "PHLX Semiconductor Sector Index (SOX) Historical Data – March 2026." MarketWatch, March 2026.
- [16] Micron Technology. "Micron Completes Acquisition of PSMC Tongluo

P5 Fab.” Micron, March 16, 2026.

[17] Murata Manufacturing. “Murata Announces Price Adjustment for Selected MLCC Products.” Murata, March 15, 2026.

[18] Nasdaq. “PHLX Semiconductor Sector Index (SOX) Price History.” Nasdaq.com, March 2026.

[19] NVIDIA. “GTC 2026 Keynote: The Age of Physical AI.” NVIDIA, March 16, 2026.

[20] Omdia. “Power Semiconductor Market Share Report 2025.” Omdia, March 2026.

[21] Onsemi. “Onsemi Announces Selective Product Price Adjustment.” Onsemi, March 16, 2026.

[22] Politico Europe. “EU Tightens Grip on Foreign Investment in Strategic Tech.” Politico Europe, March 15, 2026.

[23] Reuters. “US Commerce Department Withdraws Proposed AI Chip Export Rule.” Reuters, March 13, 2026.

[24] Reuters. “SK Hynix to Buy High-NA EUV Equipment from ASML for \$8 Billion.” Reuters, March 24, 2026.

[25] Rohm Semiconductor. “Rohm, Toshiba, Mitsubishi Electric Sign MOU to Merge Power Semiconductor Businesses.” Rohm, March 27, 2026.

[26] Samsung Electronics. “Samsung Confirms Q1 DRAM Contract Price Increase.” Samsung, March 2026.

[27] SK Hynix. “SK Hynix 2025 Annual Report and 2026 Outlook.” SK Hynix, March 2026.

[28] STMicroelectronics. “STMicroelectronics Announces Price Adjustment for Core Product Lines.” STMicroelectronics, March 24, 2026.

[29] S&P Global. “China Manufacturing PMI – February 2026.” S&P Global, March 2026.

[30] S&P Global. “Eurozone Manufacturing PMI – February 2026.” S&P Global, March 2026.

[31] S&P Global. “Japan Manufacturing PMI – February 2026.” S&P Global, March 2026.

[32] S&P Global. “South Korea Manufacturing PMI – February 2026.” S&P

Global, March 2026.

[33] S&P Global. "US Manufacturing PMI – February 2026." S&P Global, March 2026.

[34] Semiconductor Industry Association (SIA). "Global Semiconductor Sales Increase 3.7% Month-to-Month in January." SIA, March 6, 2026.

[35] Texas Instruments. "TI Announces Second Price Increase, Effective April 1." Texas Instruments, March 2026.

[36] TrendForce. "Analog IC Suppliers Announce Price Hikes as Costs Rise." TrendForce, March 10, 2026.

[37] TrendForce. "DRAM Contract Prices Surge in Q1 2026 as AI Demand Tightens Supply." TrendForce, March 15, 2026.

[38] TrendForce. "Global Foundry Capacity Utilization Exceeds 90% in Q4 2025." TrendForce, March 2026.

[39] U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA). "Personal Consumption Expenditures Price Index – January 2026." BEA, February 27, 2026.

[40] U.S. Department of Commerce, International Trade Administration. "American AI Exports Program Launched." AIExports.gov, March 16, 2026.

[41] U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics. "Consumer Price Index – January 2026." BLS, February 12, 2026.

[42] U.S. Department of the Treasury. "Treasury Auction Results – 20-Year Bond, February 2026." Treasury.gov, February 25, 2026.

[43] World Semiconductor Trade Statistics (WSTS). "Monthly Semiconductor Sales Data – January 2026." WSTS, March 2026.

[44] Yonhap News Agency. "S. Korea Unveils 8.6 Tril. Won for R&D in Semiconductor, AI, Battery." Yonhap News Agency, March 13, 2026.

[45] CCTV4. "中东冲突致氦气价格飙升超 50% 全球存储芯片供应链承压." CCTV4, 2026 年 3 月 27 日.

[46] 东方财富网. "卡塔尔氦气断供风险发酵 存储行业或迎涨价潮." 东方财富网, 2026 年 3 月 28 日.

[47] 共同通信社. "経済安保法改正案、政府が閣議決定 重要物資の範囲拡大." 共同通信社, 2026 年 3 月 19 日.

[48] 国家自然科学基金委员会. "集成芯片前沿技术科学基础重大研究计划 2026

年度项目指南。” 国家自然科学基金委员会, 2026 年 3 月.

[49] 工商时报. “六大台系 IC 设计厂商集体涨价 驱动 IC 涨幅最高 20%.” 工商时报, 2026 年 3 月 30 日.

[50] 经济日报. “晶合集成 6 月 1 日起代工费统一上调 10% 成熟制程涨价潮蔓延.” 经济日报, 2026 年 3 月 13 日.

[51] 经济日报. “台积电 2nm 产能排至 2028 年 英伟达被迫调整设计.” 经济日报, 2026 年 3 月 20 日.

[52] 科技新报. “瑞萨电子 AI 服务器电源 IC 需求强劲 交期延长至 24-38 周.” 科技新报, 2026 年 3 月 25 日.

[53] 联合新闻网. “微芯科技汽车级 MCU 供不应求 热门型号交期超 30 周.” 联合新闻网, 2026 年 3 月 28 日.

[54] 中国证券报. “兆易创新 2025 年净利润增长 49.47% 在手订单超 55 亿元.” 中国证券报, 2026 年 3 月 31 日.

[55] 韩国科学技术信息通信部. “K-NVIDIA 육성 프로젝트 공동 간담회 개최.” 韩国科学技术信息通信部, 2026 年 3 月 17 日.

[56] 韩国国会. “한미 전략투자 관리에 관한 특별법안 의결.” 韩国国会, 2026 年 3 月 12 日.

[57] 澎湃新闻. “英伟达关闭迪拜办公室 中东数据中心遭袭波及 AI 服务.” 澎湃新闻, 2026 年 3 月 24 日.

[58] 人民网韩国频道. “韩国芯片厂商紧急应对氦气供应危机.” 人民网, 2026 年 3 月 13 日.

[59] 日本经济新闻. “経済安保法改正案、閣議決定 海外事業支援を新設.” 日本经济新闻, 2026 年 3 月 19 日.

[60] 日本内阁官房. “経済安全保障推進法改正案の閣議決定について.” 日本内阁官房, 2026 年 3 月 19 日.

[61] 深圳市工业和信息化局. “深圳市加快推进人工智能服务器产业链高质量发展行动计划 (2026—2028 年).” 深圳市工业和信息化局, 2026 年 3 月.

[62] 同花顺财经. “氦气现货价格翻倍 三星、SK 海力士抢购.” 同花顺财经, 2026 年 3 月 30 日.

[63] 新华网客户端. “伊朗塔斯尼姆通讯社点名科技巨头中东设施.” 新华网, 2026 年 3 月 17 日.

[64] 央视新闻. “卡塔尔拉斯拉凡工业城遭无人机袭击 氦气工厂停产.” 央视新闻,

2026 年 3 月 3 日.

[65] 中国国家统计局. “2026 年 2 月中国制造业采购经理指数运行情况.” 国家统计局, 2026 年 3 月 1 日.

[66] 中国台湾地区国家科学及技术委员会. “AI 新十大建設-高速量子運算國家戰略發布會.” 国家科学及技术委员会, 2026 年 3 月 6 日.

[67] 中华人民共和国国家发展和改革委员会. “关于培育壮大六大新兴支柱产业的指导意见.” 国家发展改革委, 2026 年 3 月.

[68] 中华人民共和国工业和信息化部. “优质中小企业梯度培育管理办法 (2026 年修订).” 工业和信息化部, 2026 年 3 月.

[69] 中华人民共和国国务院. “中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要.” 国务院公报, 2026 年 3 月.

[70] 中央社. “量子國家隊升級國際隊 國科會：以半導體優勢邀合作.” 中央社, 2026 年 3 月 6 日.

[71] The Motley Fool. "Stock Market Today: Microsoft ' s FY26 Capex Outlook." Mar 27, 2026.

[72] AWS Blog. "AWS and NVIDIA Deepen Strategic Collaboration to Accelerate AI." Mar 20, 2026.

[73] Pure AI. "At GTC 2026, NVIDIA, AWS, and Google Cloud Shift Focus to AI Infrastructure." Mar 20, 2026.

[74] YouTube (Tech Analysis). "Cambricon Triples Capacity to Fill NVIDIA Embargo Gap." Mar 2026.

[75] OICA. "OICA's 5 Major News Items Summarized: Tesla and BYD." Mar 24, 2026.

[76] S&P Global. "Automotive Market Trends 2026: AI Capacity Risks." Jan 2026.

[77] Intuition Labs. "Top 20 Medtech Companies Using AI: GE HealthCare." Mar 2026.

[78] Morningstar. "Global Helium-Free MRI Scanners Market to Reach \$4.2B." Mar 31, 2026.

[79] PR Newswire. "Surgical Robotic Systems Market Set to Reach \$30 Billion." Mar 10, 2026.

[80] The Edge Singapore. "Siemens: Industry Demands Shield Against AI

Disruption." Mar 24, 2026.

[81] Vietnam Investment Review. "Foxconn Pumps Additional \$287M into Bac Ninh." Mar 2026.

[82] Huawei Enterprise. "Huawei Leading Wi-Fi 7 Shipments at 2 Million Units." Mar 17, 2026.

[83] Robozaps. "Humanoid Robot News: Real-World Demand Accelerates." Mar 22, 2026.

[84] The Straits Times. "Agibot Reaches 10,000 Units as Robot Demand Surges." Mar 30, 2026.

[85] The Straits Times. "Orbbec and LionsBot Strengthen Robotics Partnership." Mar 24, 2026.

[86] Robotics 24/7. "March 2026 Robotics Recap: Trends and Innovations." Mar 2026.

[87] 芯智讯, DDR5 大降价! 市场“逆转”还是“假摔”? , 2026 年 3 月 29 日

[88] 快科技, 与 AI 抢芯片! 车规内存价格暴涨 300% 车企高管喊话: 买车要趁早, 2026 年 3 月 10 日

[89] IT 之家, Counterpoint: 部分存储器春节前后价格翻倍有余, 供应短缺将持续到 2027H2, 2026 年 3 月 12 日

[90] 巨丰财经, 三星 NAND 二季度再涨 100%, 国产产业链有望受益涨价周期, 2026 年 3 月 9 日

[91] 芯语, 突发! 存储巨头铠侠发布停产通知, 2026 年 3 月 19 日

[92] DIGITIMES, 低容量 eMMC 供应大断裂 2Q 价格传将「两倍跳」, 2026 年 3 月 17 日

[93] 太平洋科技, 被美国、韩国厂商牵着鼻子走! 国产存储到了必须突围的时候, 2026 年 3 月 19 日

[94] 中国汽车报, 2026 年, 成本终结“以价换量”? | 焦点访谈, 2026 年 3 月 28 日

[95] 搜狐, 电脑内存条终端市场暴跌? 经销商称上游抛货套现, 价格是否反转有待观察, 2026 年 3 月 31 日

[96] 芯语, 存储急缺! 群联 CEO: 仅能满足 30% 需求, 70% 缺口难解, 2026 年 3 月 24 日

[97] 道通存储, 2026 年 3 月企业级服务器硬盘价格为何持续上涨? 选购时该关注

哪些指标? , 2026 年 3 月 31 日

[98] 闪存市场, 群联潘健成: Wafer 现货已暴涨 6 倍, 今年持续看涨, 500 亿库存
战略性备货力保长单, 2026 年 3 月 20 日

[99] 芯封风口, 超前布局! 存储大厂库存 350 亿, 2026 年 3 月 28 日

[100] 新浪财经, 机械硬盘价格连续 4 个季度上涨, 2026 年 3 月 13 日

[101] 华尔街见闻, 微软等云大厂开始签“存储采购强制性长约”, “存储周期”将
重塑, 2026 年 3 月 21 日

[102] 半导体产业纵横, 存储涨价后遗症来了, 2026 年 3 月 6 日

[103] 新浪财经, 芯片涨价潮扩散! 思特威、希荻微等公司接连提价 低毛利产品为
涨价主力, 2026 年 4 月 3 日

[104] 芯资讯, 恩智浦宣布: 4 月 1 日起涨价! , 2026 年 3 月 12 日

[105] SEMI 大半导体产业网, 意法半导体: 华虹 40nm 代工生产的 STM32 MCU 开
始交付, 2026 年 3 月 24 日

[106] 芯师爷, 4 月, 这些半导体涨价函正式生效! , 2026 年, 3 月 31 日

免责声明

安芯易电子商务（深圳）有限公司(下称“安芯易公司”)所发布的月度报告由安芯易公司市场部基于现已公开的资料、信息、研究报告等进行整理编制而成。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映安芯易公司在报告发布当期的判断、观点，仅供学习参考之用，不构成对所述产品的出价、征价、要约或要约邀请，不构成任何合同或承诺的基础，不构成买卖任何投资工具或者达成任何交易的推荐，亦不构成任何投资、采购及其他应用建议和指导，对任何因直接或间接使用本报告涉及的信息和内容或者据此进行交易、投资所造成的一切后果或损失，安芯易公司不承担任何法律责任。因此，读者在阅读本报告时应保持警惕，并进行独立的判断和分析。

安芯易公司对本报告中所引用的资料、研究报告所涉及的或从第三方媒体获得的信息及数据的真实性、准确性、完整性和及时性不作任何明示或默示的保证。所发布的信息、观点以及数据有可能因发布日之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效，但安芯易公司不承担更新不准确或过时的信息、观点以及数据的义务，在对相关信息进行变更或更新时亦不会另行通知。

该报告版权归安芯易公司及相关内容提供方所有，未经授权，任何人不得以任何方式转载、修改、翻版、分发、复制、发表。

安芯易电子商务（深圳）有限公司

2026 年 3 月



安芯易隶属于Ample Solutions集团,成立于2008年,在全球拥有8个办公室,专注于为全球电子制造业客户提供元器件全球采购及供应链服务。我们始终秉持“专注、专业、坚韧、谦卑”的核心价值观,为客户提供卓越服务,助力客户成功。

我们拥有100+资深采购专家,并与来自全球的10000+供应商建立合作,致力于以更快的速度,更低的成本,为客户解决元器件供应链问题。

在深圳和香港,我们建立了两个高标准品质控制中心,严格遵循国际品质控制体系。从供应商管理到品质检测,全方位地防范风险,确保客户的元器件供应链安全和稳定。



洞察行情 精准决策

